



Orbotech Nuvogo™ 780/780XL

量産向けダイレクトイメージング装置 (DI)



Orbotech Nuvogo 780/780XL

Orbotech Nuvogo 780/780XLは、高多層基板、HDI基板向けの量産用ダイレクトイメージング装置です。製造現場で実証されている Large Scan Optics™ (LSO) テクノロジーとMultiWave Laser™ (マルチ・ウェーブ・レーザー) テクノロジーにより、様々なレジストに対して高品質な露光が可能であり、トータルコスト(TCO)の削減を実現します。



特長

量産向けデジタルイメージング

- ハイパワーレーザー使用による高いスループット
- 革新的な2段テーブル搬送メカニズムにより装置稼働時間を最大限に活用
- インラインをはじめとする様々なオートメーションに対応
- クリーンな作業環境

MultiWave Laserテクノロジーによる幅広いレジストへの対応

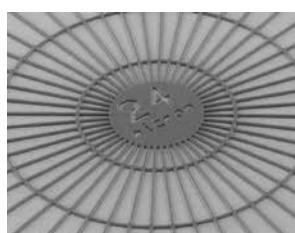
- 様々なレジストに高い生産性で対応
- MultiWave Laserテクノロジーによる高品質パターン形成

LSOテクノロジーによるすぐれた露光品質

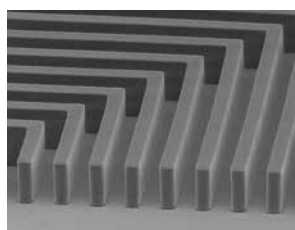
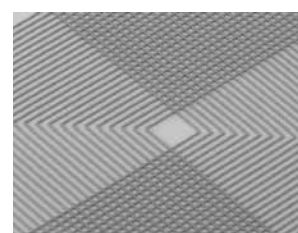
- 深い焦点深度により、歪んだ基板でも均一なパターンを形成
- 独自の光学設計による最適な露光
- ±12μmの高精度な位置合わせ

製造コストの大幅削減

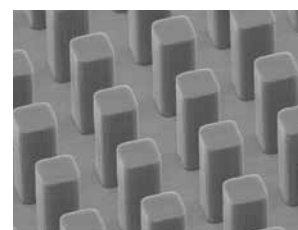
- 高い露光稼働率により、長期的に明確なコストが削減できます
- 様々なレジストの種類に対応することにより、コストの点からの材料選択も可能となります



最小24μmまでのファインパターンに対応



MultiWave Laserテクノロジーによるダブルラミネーションレジストへの露光



テクノロジー



LSO™ Technology



MultiWave Laser™ Technology

量産向けデジタルイメージング装置

MultiWave LaserテクノロジーによるOrbotech Nuvogo 780/780XLは、最先端の光学系を搭載しファインパターンを高スピードで露光することができます。2段テーブル搬送メカニズムは、搬送における露光時間のロスを削減し、稼働時間を最大限活用することができます。また、すばやいセットアップが可能のため、ジョブ切替を効率的に行い、装置稼働時間を最大限に活用します。Orbotech Nuvogo 780/780XLはクリーンな環境で全自動化で作業を行うため、高品質な生産を行うことができます。

MultiWave Laserによる幅広いレジストへの対応

MultiWave Laserを搭載したOrbotech Nuvogo 780/780XLは様々なレジスト素材に対応し、最大限のフレキシビリティを提供いたします。また、歪んだ基板にも高い均一性で露光が可能です。

LSOテクノロジーによるすぐれた露光品質

すでに製造現場で実証済みのLSOテクノロジーとの併用により、深い焦点深度を保ちながら、厚さや素材の違う製品（フレックス、リジッドフレックス基板）にも対応することが可能です。

様々なスケーリングモード

- オートスケーリング、固定スケーリング、グループスケーリング、ワイズスケーリング

トレーサビリティ対応

- 基板に英数字、1次元バーコード、2次元バーコード（データマトリクスコード）で、シリアルナンバー、日付スタンプ、マシンID情報を露光することで、トラッキングや不具合品などフィードバックが可能

高精度なレジストレーション

- ±12μmの精度

簡単操作

- 高速&簡単セットアップを可能にする直感的かつユーザーフレンドリーなインターフェイス
- CAMとのシームレスな接続による高速、簡単セットアップが可能
- あらゆる生産仕様に応じて、多様なアライメントマークに対応

製造コストの大幅削減

Orbotech Nuvogo™ Diシリーズは、高難易度化していく量産製造過程において、コスト削減を提供いたします。その高い生産性で基板1枚あたりの露光コストを削減し、低コストでの最大限の製造利益をご提供することができます。製造にかかるコストなどを削減することができます。また、様々なレジストタイプに対応することにより、コスト視点でのレジスト露光をご提案することができ、更なるコスト削減を提供することができます。

仕様

	Orbotech Nuvogo 780	Orbotech Nuvogo 780XL
最大スループット*	300 (面 / 時) 基板サイズ: 609.6x457mm	290 (面 / 時) 基板サイズ: 635x457mm
最小パターンサイズ	24μm	
解像度	2.0μm	
位置合わせ精度 (FtG) **	±12μm	
表裏位置合わせ精度 (FtB) **	24μm	
最大基板サイズ	635mm x 660mm	660mm x 812mm
最大露光サイズ	609.6mm x 660mm	635mm x 812mm
基板厚	0.025mm - 8mm	
設定露光エネルギー範囲	25 - 2,200 mJ/cm ²	

*フォトレジストの特性により異なります

**すべて3σ、フルフォーマットで測定

仕様は予告なく変更することがあります

KLA SUPPORT

高い歩留まりを実現するKLAのソリューションにとって、装置の生産性維持は非常に重要です。この実現のため、当社ではメンテナンス、グローバルでのサプライチェーン管理、コスト削減、老朽化の緩和、装置移設、性能・生産性の向上、認証ツールの再販売などに注力しています。

© 2022 KLA Corporation. KLAは全世界において著作権に関する権利を有します。当社は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの仕様を予告なく変更する権利を有します。「オルボテック」は、KLAカンパニーであるOrbotech Limitedの登録商標です。「KLA」とKLAのロゴは、KLA Corporationの登録商標です。記載されたブランド名および製品名は全て各社の登録商標である可能性があります。

KLA Corporation
TEL: 03-6367-2505
Email: PCB-Sales@orbotech.com
www.kla.com
Rev_7.0 4-05-2022 (J)